

Express5800/R120h-2M スペック詳細

2019年03月26日版

フレームモデル

製品名称			Express5800/R120h-2M								
モデル名			8x2.5型ドライブモデル N8100-2562Y		24x 2.5型ドライブモデル N8100-2563Y		8x3.5型ドライブモデル N8100-2564Y		12x3.5型ドライブ N8100-2565Y		
製品型名											
CPU	Processor		インテル® Xeon® プロセッサ Bronze 3104(6C/6T, 1.70 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Bronze 3106(8C/8T, 1.70 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4108(8C/16T, 1.80 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4110(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4112(4C/8T, 2.60 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Silver 4114(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4116(12C/24T, 2.10 GHz, 16.50MB, TDP 85W), Gold 5115(10C/20T, 2.40 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5118(12C/24T, 2.30 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 5120(14C/28T, 2.60 GHz, 19.25MB, TDP 105W), Gold 5122(4C/8T, 3.60 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6126(12C/24T, 2.60 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6128(6C/12T, 3.40 GHz, 19.25MB, TDP 115W), Gold 6130(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 6132(14C/28T, 2.60 GHz, 19.25MB, TDP 140W), Gold 6134(8C/16T, 3.20 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6136(12C/24T, 3 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6138(20C/40T, 2GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6140(18C/36T, 2.30 GHz, 24.75MB, TDP 140W), Gold 6142(16C/32T, 2.60 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6144(8C/16T, 3.50 GHz, 24.75MB, TDP 150W),Gold 6146(12C/24T, 3.20 GHz, 24.75MB, TDP 165W), Gold 6148(20C/40T, 2.40 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6150(18C/36T, 2.70 GHz, 24.75MB, TDP 165W), Gold 6152(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6154(18C/36T, 3GHz, 24.75MB, TDP 200W), Platinum 8153(16C/32T, 2 GHz, 22MB, TDP 125W), Platinum 8156(4C/8T, 3.60 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Platinum 8158(12C/24T, 3GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8160(24C/48T,2.10 GHz, 33MB, TDP 150W), Platinum 8164(26C/52T, 2GHz, 35.75MB, TDP 150W), Platinum 8168(24C/48T, 2.70 GHz, 33MB, TDP 205W), Platinum 8170(26C/52T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8176(28C/56T, 2.10 GHz, 38.50MB, TDP 165W), Platinum 8180(28C/56T, 2.50 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 6134M(8C/16T, 3.20GHz, 24.75MB, TDP 130W), Platinum 8180M(28C/56T, 2.50 GHz, 38.50MB, TDP 205W)								
		標準搭載数 / 最大搭載数	0/2								
		コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)								
		インテル® 64	対応								
		インテル® ハイチャイゼーション・テクノロジー	対応								
		インテル® ハイバースレディング・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3104/3106は除く)								
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3104/3106は除く)								
		CPUソケット形状	LGA3647								
		ホットプラグ	-								
		冷却方式	ファンなしヒートシンク								
チップセット	インテル® C621 チップセット										
メモリ	搭載容量 標準 / 最大 メモリソケット数 増設単位 搭載メモリ 最大動作周波数 メモリバス帯域(チャネルあたり) メモリアクセス方式 誤り検出・訂正 メモリスベアリング メモリミラーリング ホットプラグ モジュールピン数 動作電圧 バッファ機能	搭載容量 標準 / 最大 メモリソケット数 増設単位 搭載メモリ 最大動作周波数 メモリバス帯域(チャネルあたり) メモリアクセス方式 誤り検出・訂正 メモリスベアリング メモリミラーリング ホットプラグ モジュールピン数 動作電圧 バッファ機能	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) 24 1 DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB) 2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います) 21.3GB/s インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート) ECC, x4 SDDC 対応 対応 - 288ピン 1.2V 対応								
			補助 記憶 装置	内蔵スロット フロント リア 内部 内蔵標準 内蔵最大 ホットスワップ	内蔵スロット フロント リア 内部 内蔵標準 内蔵最大 ホットスワップ	8x2.5型ドライブ 8x2.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)		24x2.5型ドライブ		8x3.5型ドライブ	
2x 2.5型ドライブ(オプション 最大3個), 3x 3.5型ドライブ(オプション 最大1個) 2x M.2 SATAスロット											
2.5型HDD: SATA 48TB (24x 2TB), SAS 57.6TB (24x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 92.16TB (24x 3.84TB), SAS SSD: 46.08TB(24x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)		2.5型HDD: SATA 60TB (30x 2TB), SAS 72TB (30x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 115.2TB (30x 3.84TB), SAS SSD: 57.6TB (30x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)				3.5型HDD : SATA 180TB(15x 12TB)ニアライ ンSAS 180TB(15x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 8TB (4x 2TB), SAS 9.6TB(4x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 15.36TB(4x 3.84TB), SAS SSD: 7.68TB (4x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)		3.5型HDD : SATA 228TB(19x 12TB)ニアライ ンSAS 228TB(19x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 4TB (2x 2TB), SAS 4.8TB(2x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 7.68TB(2x 3.84TB), SAS SSD: 3.84TB (2x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)			
対応											
SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)											
内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1 オプション: Flash FDD (1.44MB) *2											
標準構成 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト、フルレンジ) 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、フルレンジ) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト、ハーフレンジ) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。) PCI Express 1.1, 2.0, 3.0											
マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200											
1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 2xUSB2.0(Type A)(オプション) *12											
1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用) 1x USB2.0(Type A) (BMC用)											
標準インターフェース	フロント										
	リア		2x USB3.0 (TypeA) , 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE- 対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE- 対応 (RJ-45)) 1x シリアルポート (オプション) 2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 2.0 Port								
	内部		オンボード 1x Broadcom® BCM5719 対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います) 対応 対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報を参照ください) PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応								
ネットワーク	実装形式										
	コントローラ		1x Broadcom® BCM5719								
	チーミング FEC / GEC ジャンボフレーム PXE / iSCSI ブート		対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います) 対応 対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報を参照ください) PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応								
リモート マネージメント	コントローラ		BMC Marvell PHY								
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)			対応								
キーボード / マウス			オプション								
BIOS Version (出荷当初)			System ROM U30 v1.02 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)								
BMC Firmware Revision (出荷当初)			1.10 (最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)								
System Sleep State			S0, S5								
冗長電源			対応 (オプション、ホットプラグ可)								
冗長ファン			対応 (標準、ホットプラグ可)								
筐体デザイン			1Uラックマウント								
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)			445.5mm × 679.4mm × 87.3mm (2.5型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず) 445.5mm × 730.2mm × 87.3mm (3.5型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず)								
質量 (最小/ 最大)			15kg / 38kg		15kg / 39kg		15kg / 45kg		15kg / 46kg		
電源			選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-159, 160) 500W/800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz 電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz 電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可) (最大 : 2) (電源ケーブルは必須選択オプション) *10 908VA / 899W (800W電源最大値)								
消費電力(100V最大構成時、最大電力)											
消費電力(200V最大構成時、最大電力)			1271VA / 1270W *7		1329VA / 1326W *7		1217VA / 1217W *7		1247VA / 1244W *7		
発熱量			4572KJ/h		4774KJ/h		4382KJ/h		4479KJ/h		
省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率			対象外		対象外		対象外		対象外		
音量			34dBA / 34dBA								
測定方式											
温度条件			ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床上 : 1.5m, サーマとの距離: 1m), サーバ設置(床上: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10～35℃(条件付きで5～40℃/45℃対応可) *11, 保管時: -30～60℃ 動作時: 8～90%, 保管時: 5～95%(動作時/保管時ともに結露しないこと)								
湿度条件											
ハードウェア認証規定			VCCIクラス A								
OS認証			Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware								
主な添付品			スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル								
無償保証内容			3年オンサイト保守サービス(月～金, 9:00～18:00, 翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証								
インストールOS											
サポートOS	NECサポート		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 6.9以降 *5 *9 Red Hat® Enterprise Linux® 7.3以降 *5, VMware ESXi™ 6.0 Update3, VMware ESXi™ 6.5 Update1以降, VMware ESXi™ 6.7 最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います								
動作確認OS *6											

ExpressSelectionPack

製品名称			ExpressSelectionPack		
モデル名			8x.2.5型ドライブモデル		
製品型名			NP8100-2562YP1Y	NP8100-2562YP2Y	
CPU	Processor		Silver 4114(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W)		
		標準搭載数 / 最大搭載数	0/2		
		コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)		
		インテル® 64	対応		
		インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー	対応		
		インテル® ハイバースレッディング・テクノロジー	対応		
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー	対応		
		CPUソケット形状	LGA3647		
		ホットプラグ	-		
		冷却方式	ファンなしヒートシンク		
チップセット			インテル® C621 チップセット		
メモリ		搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB)		
		メモリソケット数	24		
		増設単位	1		
		搭載メモリ	DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB)		
		最大動作周波数	2666MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)		
		メモリバス帯域(チャネルあたり)	19.2GB/s		
		メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)		
		誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC		
		メモリスベアリング	対応		
		メモリミラーリング	対応		
		ホットプラグ	-		
		モジュールピン数	288 ピン		
		動作電圧	1.2V		
		バッファ機能	対応		
		補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント
リア	2x 2.5型ドライブ(オプション 最大3個), 3x 3.5型ドライブ(オプション 最大1個)				
内部	2x M.2 SATAスロット				
内蔵標準	-				
内蔵最大	2.5型HDD: SATA 48TB (24x 2TB), SAS 57.6TB (24x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 92.16TB (24x 3.84TB), SAS SSD 46.08TB(24x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)				
	対応				
	インタフェース規格とRAID構成			SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)	
	光ディスクドライブ			内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1	
FDD				オプション: Flash FDD (1.44MB) *2	
拡張ベイ				-	
拡張スロット	対応スロット	標準構成 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト、フルレンジス) 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、フルレンジス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト、ハーフレンジス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)			
		PCI Express 1.1, 2.0, 3.0			
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB			
		グラフィック表示 と 解像度 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200			
標準インタフェース	フロント	1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 2xUSB2.0(Type A)(オプション) *12			
	リア	2x USB3.0 (TypeA) , 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-対応 (RJ-45)) 1x シリアルポート (オプション)			
	内部	2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 2.0 Port			
ネットワーク	実装形式	オンボード			
	コントローラ	1x Broadcom® BCM5719			
	チームング	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)			
	FEC / GEC	対応			
	ジャンボフレーム	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)			
リモートマネージメント	PXE / iSCSI ブート	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応			
	コントローラ	BMC			
マネージメント用ポート		Marvell PHY			
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)			対応		
キーボード / マウス			オプション		
BIOS Version (出荷当初)			System ROM U30 v1.02 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)		
BMC Firmware Revision (出荷当初)			1.10 (最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)		
System Sleep State			S0, S5		
冗長電源			対応 (オプション, ホットプラグ可)		
冗長ファン			対応 (標準, ホットプラグ可)		
筐体デザイン			1Uラックマウント		
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)			445.5mm x 679.4mm x 87.3mm (2.5型ドライブモデル: フロントベゼル/レール/突起物含まず) 445.5mm x 730.2mm x 87.3mm (3.5型ドライブモデル: フロントベゼル/レール/突起物含まず)		
質量 (最小/ 最大)			15kg / 38kg 選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-159, 160) 500W/800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz 電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz 電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) (電源ケーブルは必須選択オプション)		
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)			別紙参照		
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)			別紙参照		
発熱量			別紙参照		
省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率			対象外		
音量			34dBA / 34dBA		
音圧レベル (待機時 / 高負荷時) *4			ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床上: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床上: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10~35℃(条件付きで5~40℃/45℃対応可) *11, 保管時: -30~60℃ 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)		
測定方式			VCCI クラス A		
ハードウェア認証規定			Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware		
OS認証			スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル		
主な添付品			3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)		
無償保証内容			3年パーツ保証		
インストールOS			Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard *8	Microsoft® Windows Server® 2016 Standard	
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter,			
動作確認OS *6			最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います		

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで, ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで, MD2 = 167.6mmまで を示します

注釈

- *1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
- *2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD製品概要と利用ケース」の構成ガイドを参照下さい。
- *3 VMware ESXi 6.Cをインストールした場合、USB2.0で動作します。
- *4 特定構成(2xCPU(Xeon Silver 4114), 2x16GB DIMM, 1xRAIコントローラ, 標準ファン, 1x500W電源)での騒音値
- *5 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
- *6 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
- *7 CPU TDPごとの最大電力は8.1.2をご参照ください。
- *8 本製品はお客様から提供を要求されている場合に限り、お客様へ販売することが認められています。ご購入の際には、事前にお客様より Windows Server 2016のライセンス条項に同意していただく必要があります。
詳細は<http://jpn.nec.com/windowsserver/2016/down.html> をご覧ください。
- *9 省電力のためのCPU周波数制御においては、HW自動制御の設定が本装置の標準仕様ですが、RHEL6ではCPU周波数制御は未サポートとなります。
- *10 DC-48V電源のほかにDC380V電源を本装置で活用されたい方は、弊社営業まで別途お問い合わせください。
- *11 40℃/45℃環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細は「リファレンス」の「40℃/45℃対応についての注意事項」をご参照ください。
- *12 オプションの「N8154-117 内蔵DVDドライブ増設キット」搭載時